

# Make it EZ! TIのマイコン



テキサス・インスツルメンツでは 800 品種を超えるマイコンを取り揃えています。汎用製品でありながら特長をもった製品群は、マイコンに要求されるさまざまなご要望におこたえます。組込み製品に要求される超低消費電力や、産業機器が求めるリアルタイム制御、あるいはイーサネットや CAN、USB などネットワークにも対応しています。さらに世界有数の半導体サプライヤであり、最大の ARM 製品のサプライヤである TI であれば、マイコンからプロセッサまで、シームレスに製品を選択することが可能であり、プラットフォームの共通化で開発期間の短縮とコスト削減に大きく貢献します。

## 主な特長

### ●800を超えるラインアップ

- ✓業界トップクラス、超低消費電力マイコン MSP430ファミリー(最大25MHz)
- ✓業界初の65nmで高集積、低消費電力、高機能を実現したStellaris(ステラリス)ファミリー(最大80MHz)
- ✓全てがリアルタイム制御、ハイスピードマイコン C2000ファミリー(Piccolo, Delfino, Concerto, F28x)(最大300MHz)
- ✓機能安全規格IEC61508およびISC26262向けセーフティ・マイコンHercules(ヘラクレス)ファミリー(最大220MHz)

### ●使いやすいツール群

- ✓エミュレーション回路搭載評価キットがわずか\$4.3からご用意
- ✓わずか10分で評価が開始できるオールインワン・パッケージ
- ✓DIMMカードシステムが柔軟な開発環境構築と、容易な量産移行を実現

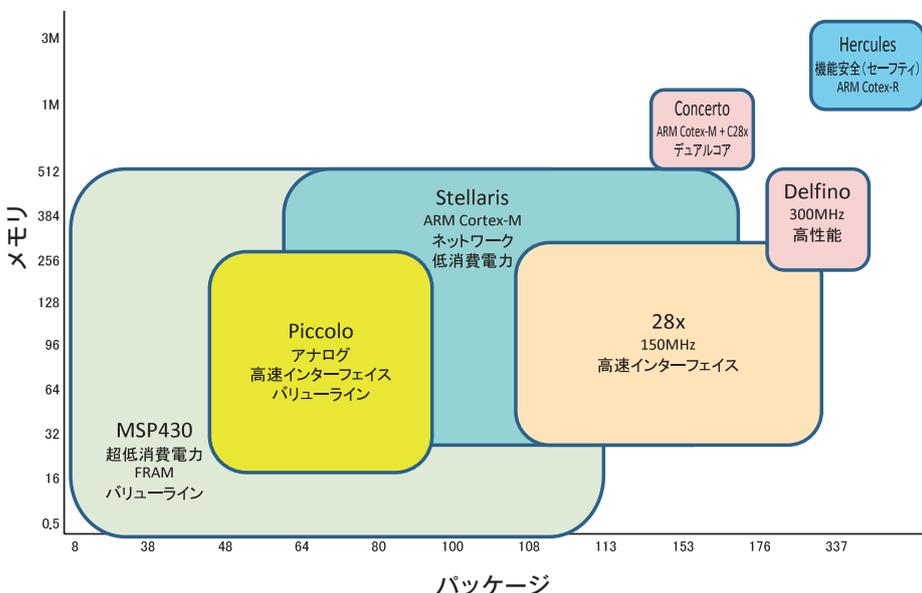
### ●革新的技術への対応

- ✓最先端の高速不揮発性メモリ(FRAM)を搭載
- ✓超低消費電力技術によりローパワーからノーパワーへ
- ✓内部発信回路や高速ADCなど高機能アナログ搭載
- ✓RFの融合により設計の自由な設計を可能に

## MCUセレクション・ツール

### ●自分で選べる簡単Webツール

- ✓メモリサイズやピン数、周波数などを選ぶだけ
- ✓最速1分で推奨デバイスを表示



## 主な製品群

### MSP430ファミリー

- FR5x 新メモリFRAM搭載
- F5x ハイパフォーマンス
- G2x バリユーライン

### C2000ファミリー

- Piccolo 高機能アナログ混載
- Delfino 最大300MHz
- Concerto ARM+c28xデュアルシステム
- F28x 最大150MHz

### Stellaris(ステラリス)ファミリー

- LM3S イーサネットPHY内蔵、USB、CAN搭載
- LM4F ARM Cortex-M4Fコア、EEP ROM搭載 低消費電力

### Hercules(ヘラクレス)ファミリー

- デュアルコア・ロックステップ方式Cortex-Rコアメモリ、ECC、ハードウェアBIST (内蔵セルフテスト)
- RM4x/TMS570LSx
- TMS470M Cortex-M3コア、メモリECC、ハードウェアBIST

## 評価キット、開発ツール

- 量産導入可能な簡単キットを多数ご用意
  - ✓ 用途別、価格別にご用意
  - ✓ オンボードエミュレーションも可能
  - ✓ 回路図、部品表もご提供

### タッチパネルコントロール

MSP430



Launch Pad タッチパネルブースターバック  
MSP-EXP430G2 \$4.30  
430boost-sensel \$10

MSP430



F5529 開発キット  
MSP-EXP430F5529 \$149

### LED ライティング

C2000



AC LEDライティング通信開発キット  
TMDSIACLEDCKIT \$699

### 再生可能エネルギー

MSP430



ソーラー・エネルギー・ハーベス  
ト開発キット  
eZ430-RF2500-SEH \$149

C2000



ソーラー検証キット  
TMDSSOLARCEXPKIT \$475  
TMDSSOLARPEXPKIT \$375

C2000



ソーラー MPPT 開発キット  
TMDSHVMPPTKIT \$550

C2000



高電圧インバーターキット  
TMDSHV1PHINVKIT \$450

### モーターコントロール

C2000



モーター制御および PFC 開発キット  
TMS1MTRPFCKIT \$369

C2000



高電圧 PFC および  
モーター制御開発キット  
TMDSHVMTRPFCKIT \$599

Stellaris



ブラシ付 DC モーター制御 CAN 対応  
リファレンス・デザイン・キット  
RDK-BDC24 \$219

Stellaris



ブラシレス DC モーター  
リファレンス・デザイン・キット  
RDK-BLDC \$219

### コネクティビティ

Stellaris



LM3S9D96 開発キット  
DK-LM3S9D96 \$425

Stellaris



13.56MHz RFID ワイヤレス・キット  
DK-EM2-7960R \$99

Stellaris



2.4GHz CC2560Bluetooth  
ワイヤレス・キット  
DK-EM2-2560B \$199

## 開発を幅広くサポート

- Web (<http://www.tij.co.jp/mcu>)
  - ✓ 無償サンプルをご提供
  - ✓ 技術資料をご提供
  - ✓ サンプルコードを自由にダウンロード
  - ✓ 参考価格、在庫状況を掲載
  - ✓ 設計サポートのページをご用意
  - ✓ エンジニア・コミュニティの場をご提供
- 製品に関するお問い合わせ：
  - ・ <http://www.tij.co.jp/pic>
  - ・ Tel: ☎ 0120-92-3326
  - ・ Fax: ☎ 0120-81-0036

- トレーニング | セミナー (<http://www.tij.co.jp/training>)
  - ✓ さまざまな内容で実施。Webや電子メールでご案内
- eニュースレター (<http://www.tij.co.jp/epletter>)
  - ✓ 各種最新情報を電子メールでご案内
- eメールアラート (<http://www.tij.co.jp/alert>)
  - ✓ ご登録頂いた製品に関する重要情報を電子メールでご連絡
- 販売特約店 (<http://www.tij.co.jp/dist>)
  - ✓ 技術サポートをご提供
- 無償サンプルおよびツール購入 ([http://www.tij.co.jp/sample\\_buy](http://www.tij.co.jp/sample_buy))
  - ✓ 評価キット、開発ツールはeStoreからオンライン購入いただけます。

# ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated (TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということの意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータブックもしくはデータシートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されておられません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されておられません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
    - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
  4. 機械的衝撃
    - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
  5. 熱衝撃
    - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
  6. 汚染
    - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
    - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上